

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2024-074

芯联集成电路制造股份有限公司

2024年前三季度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年9月30日（以下简称“报告期”）。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2024年前三季度营业收入约为45.47亿元，与上年同期相比增加约7.16亿元，同比增长约18.68%。

2、公司预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润约为-6.84亿元，与上年同期相比减亏约6.77亿元，同比减亏约49.73%。

3、公司预计2024年前三季度EBITDA（息税折旧摊销前利润）约为16.60亿元，与上年同期相比增加约7.98亿元，同比增长约92.67%。

二、上年同期业绩情况

2023年前三季度：

营业收入：38.32亿元。

归属于母公司所有者的净利润：-13.61亿元。

EBITDA（息税折旧摊销前利润）：8.62亿元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、公司 SiC、12 英寸硅基晶圆等新产品快速转化促进收入提升，2024 年第三季度营收再创历史新高。

随着新能源车及消费市场的回暖，公司产能利用率逐步提升。报告期内，公司 SiC、12 英寸硅基晶圆等新产品在头部客户快速导入和量产，以 SiC MOSFET 芯片及模组产线组成的第二增长曲线和以高压、大功率 BCD 工艺为主的模拟 IC 方向的第三增长曲线快速增长，公司营业收入快速上升，单季度同比、环比均呈现较高增长。2024 年第三季度公司营业收入约为 16.68 亿元，再创历史新高。

2、报告期内大幅减亏，第三季度毛利率转正。

2024 年第三季度公司毛利率已实现单季度转正约为 6%。报告期内，公司继续增强精益生产管理能力和供应链管理、成本控制能力等，大幅提升公司产品的市场竞争力。公司 SiC、12 英寸产品的规模效益和技术优势逐渐显现，前三季度归母净利润同比减亏约 49.73%，实现大幅减亏，公司盈利能力趋于向好。

四、风险提示

本次业绩预告为前瞻性陈述，是公司业务及财务部门基于自身专业判断进行的初步核算和预测，尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年10月14日